



<p>(51) 国際特許分類6 H01L 21/56, 21/60, 23/28, 23/30, H03H 9/25, 9/02, 9/19, H03B 5/32</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO97/02596</p> <p>(43) 国際公開日 1997年1月23日(23.01.97)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP96/01492</p> <p>(22) 国際出願日 1996年5月31日(31.05.96)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平7/164379 1995年6月30日(30.06.95) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 東芝(KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA)[JP/JP] 〒210 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 Kanagawa, (JP)</p> <p>(72) 発明者：および</p> <p>(75) 発明者／出願人 (米国についてのみ) 古川 修(FURUKAWA, Osamu)[JP/JP] 〒229 神奈川県相模原市光が丘3丁目4-23-1 Kanagawa, (JP) 千代間仁(CHIYOMA, Hitoshi)[JP/JP] 〒245 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町799-2-602 Kanagawa, (JP) 飯川和久(YABUKAWA, Kazuhisa)[JP/JP] 〒671-22 兵庫県姫路市書写435 Hyogo, (JP) 土沼健一(DONUMA, Kenichi)[JP/JP] 〒343 埼玉県越谷市東越谷2丁目4-19 Saitama, (JP)</p>		<p>(74) 代理人 弁理士 須山佐一(SUYAMA, Saichi) 〒101 東京都千代田区神田多町2丁目1番地 神田東山ビル Tokyo, (JP)</p> <p>(81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD OF PRODUCTION THEREOF</p> <p>(54)発明の名称 電子部品およびその製造方法</p> <div data-bbox="435 1264 1279 1612" data-label="Image"> </div> <p>(57) Abstract</p> <p>An electronic component and a production method thereof. This electronic component comprises a surface acoustic wave device (3) having a main plane on which a transducer (4) and a wiring pattern (5) electrically connected to the transducer are formed; a wiring substrate (1) having a wiring pattern (2) formed on at least one of the main planes thereof; a plurality of electrically conductive bumps (6) for electrically connecting both of the wiring patterns opposed to each other with a gap kept between the surface acoustic wave device (3) and the wiring substrate (1); and a molding resin (11) which is in close contact with the other main plane of the device to cover and seal the device (3) in cooperation with the wiring substrate (1). If a thermoplastic resin of higher thixotropy and higher viscosity is used, the electronic component may have a simplified structure and can be manufactured by simplified process.</p>		

(19) 日本国特許庁 (J P)

再公表特許 (A 1)

(11) 国際公開番号

WO 97 / 0 2 5 9 6

発行日 平成10年(1998) 9月22日

(43) 国際公開日 平成 9 年(1997) 1月23日

(51) IntCl⁶

識別記号

F I

H 0 1 L 21/56

21/60

23/28

23/30

H 0 3 H 9/25

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 267 頁) 最終頁に続く

出願番号 特願平9-504976
(21) 国際出願番号 PCT / J P 9 6 / 0 1 4 9 2
(22) 国際出願日 平成 8 年(1996) 5月31日
(31) 優先権主張番号 特願平7-164379
(32) 優先日 平 7 (1995) 6月30日
(33) 優先権主張国 日本 (J P)
(81) 指定国 EP (A T, B E, C H, D E, D K, E S, F I, F R, G B, G R, I E, I T, L U, M C, N L, P T, S E), C N, J P, K R, U S

(71) 出願人 株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(72) 発明者 古川 修
神奈川県相模原市光が丘 3 丁目 4 - 23 - 1
(72) 発明者 千代間 仁
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町799- 2 - 602
(72) 発明者 篠川 和久
兵庫県姫路市書写435
(72) 発明者 土沼 健一
埼玉県越谷市東越谷 2 丁目 4 - 19
(74) 代理人 弁理士 須山 佐一

(54) 【発明の名称】 電子部品およびその製造方法

(57) 【要約】

電子部品、例えばトランスデューサ部 4 およびこのトランスデューサ部に電氣的に接続する配線パターン 5 が形成された主面を有する弾性表面波素子 3 と、少なくとも一主面に形成された配線パターン 2 を有する配線基板 1 と、対向した両配線パターンを電氣的に接続し弾性表面波素子 3 と配線基板 1 との間に空隙部 10 を形成する複数の導電性バンプ 6 と、加熱溶融および硬化により少なくとも前記素子の他の主面に密着して前記素子 3 を包囲するとともに配線基板 1 とにより前記素子 3 を封止する樹脂部 11 とを具備する電子部品とその製造方法であり、従来に比し、充分チキソ性が高く、粘性も高い熱硬化性樹脂を用いることにより、簡易構造の電子部品を提供でき、また、工程の簡略化が図れる。

